



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6346.301—2015/IEC 60384-3-1:2006  
代替 GB/T 14122—1993

---

## 电子设备用固定电容器 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装 $\text{MnO}_2$ 固体电解质 钽固定电容器 评定水平 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—Part 3-1:  
Blank detail specification—Surface mount fixed tantalum  
electrolytic capacitors with manganese dioxide solid  
electrolyte—Assessment level EZ

(IEC 60384-3-1:2006, IDT)

2015-07-03 发布

2016-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

《电子设备用固定电容器》已经或计划发布的国家标准如下：

- 第 1 部分：总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器(GB/T 6346.3—2015/IEC 60384-3:2006)；
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.301—2015/IEC 60384-3-1:2006)；
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998)；
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平 E(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4-1:2000)；
- 第 6 部分：分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 14004—1992/IEC 60384-6:1987)；
- 第 6-1 部分：空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 14005—1992/IEC 60384-6-1:1987)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 10186—2012)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2012/IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(GB/T 6346.11—2015/IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.1101—2015/IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 13 部分：分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10188—2013/IEC 60384-13:2006)；
- 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10189—2013/IEC 60384-13-1:2006)；
- 第 14 部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 6346.14—2015 /IEC 60384-14:2005)；
- 第 14-1 部分：空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 6346.1401—2015/IEC 60384-14-1:2005)；

- 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982, 第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992);
- 第 15-1 部分:空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
- 第 15-2 部分:空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1992);
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10190—2012/IEC 60384-16:2005);
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ (GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器(GB/T 14579—2013/IEC 60384-17:2005);
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 14580—2013/IEC 60384-17-1:2005);
- 第 18 部分:分规范 固体(MnO<sub>2</sub>)与非固体电解质片式铝固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO<sub>2</sub>)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007);
- 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
- 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 (GB/T 15448—2013/IEC 60384-19:2005);
- 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 16467—2013/IEC 60384-19-1:2005);
- 第 21 部分:分规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
- 第 22 部分:分规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004)。

本部分为《电子设备用固定电容器》的第 3-1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 14122—1993《电子设备用固定电容器 第 3 部分:空白详细规范 片状钽固定电容器 评定水平 E(可供认证用)》。

本部分与 GB/T 14122—1993 相比,主要技术变化如下:

- 将产品名称改为表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器;
- 评定水平从 E 改为 EZ;
- 根据其上层规范的修改而进行相应的变更。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 60384-3-1:2006《电子设备用固定电容器 第 3-1 部分:空白详细

规范 表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ》。为了便于使用,本部分作了下列编辑性修改:

——删除了 IEC 60384-3-1:2006 前言部分;

——表中的脚注采用小写英文字母。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司。

本部分主要起草人:张玉芹、杨立明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 14122—1993。

# 电子设备用固定电容器

## 第 3-1 部分：空白详细规范

### 表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质 钽固定电容器 评定水平 EZ

#### 空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充性文件,它包括详细规范的格式、编排和最少内容要求。不遵守这些要求的详细规范,认为是不符合电子元件质量评定体系要求的标准。

制定详细规范时应考虑分规范 1.4 的内容。

首页括号中数字标注的位置上应填写下列相应内容:

#### 详细规范的识别

- [1] 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准机构。
- [2] IEC 或国家的详细规范标准编号、发布日期以及国家标准体系所要求的任何其他的内容。
- [3] IEC 或国家的总规范编号及其版本号。
- [4] IEC 或国家标准的空白详细规范编号。

#### 电容器的识别

- [5] 该类型电容器的简要说明。
- [6] 典型结构的说明(适用时)。

注:当电容器不是设计用于印制电路板时,在详细规范的这个位置上应该明确地加以说明。

[7] 影响互换性的主要尺寸的外形图,和(或)引用国家标准或国际文件的外形图。这种图形也可以在详细规范附录中给出。

- [8] 用途或涉及的应用类别和/或评定水平。
- [9] 重要特性的参考数据,以便在各种类型电容器之间进行比较。

[1]	[2]
电子元器件质量评定按 GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999	GB/T 6346.301—2015/IEC 60384-3-1:2007
[3]	[4]
外形图(…角视图)	表面安装 MnO <sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器
[7]	[5]
在给定尺寸范围内允许形状有所不同(见表 1)	[6]
	评定水平: EZ
	[8]